



RF-110MK2



RF-110N2MK2

手動式リフローはんだ付け装置 RF-110MK2  
手動式N<sub>2</sub>リフローはんだ付け装置 RF-110N2MK2

RF-110MK2は手動式遠赤外線リフローはんだ付け装置です。200×200mmまでのプリント基板を両面リフローはんだ付けできます。少量多品種SMT基板の生産や、実験・試作に最適です。

RF-110N2MK2はRF-110MK2の窒素(N<sub>2</sub>)対応品です。わずかな窒素の消費で、1000ppm以下の酸素濃度を実現します。**NEW** コンベア炉と同様の温度プロファイルを最大8つ設定できます。

## 特長

- 遠赤外線(IR)1ゾーン加熱です。最大31セグメントの温度と加熱時間の設定により、温度プロファイルを設定できます。
- 200×200mmの基板まで、接着剤なしに両面リフローはんだ付けできます。
- 世界で最も小型で、安価な卓上窒素(N<sub>2</sub>)リフローはんだ付け装置です。(RF-110N2MK2)
- 1回のリフローはんだ付けに、20~30ℓとわずかな窒素量で酸素濃度1000ppm以下を達成します。(RF-110N2MK2)

## 仕様

- 加熱部 : 1ゾーン 210×210mm 高さ20mm
- ヒーター : 石英管ヒーター IR (波長: 2~10μm)
- 上部: 1kW 下部: 0.4kW
- ヒーター選択 : TOP (上部のみON)
- OFF
- FULL (上下共にON)
- 温度制御 : MAX300°C P.I.D. プログラマブル温度調節器 (最大8プログラム、各々最大31セグメント)
- 上部炉内雰囲気温度制御
- コンベア : 無し(バッチ式)
- 冷却 : 自然空冷
- 電源 : AC100/120/220V 1.5kW 50/60Hz
- N<sub>2</sub>供給量 : 20~30ℓ/回
- (RF-110N2MK2) 窒素の供給は開始からプログラムOFFまでの間。
- 外形寸法・重量 : (W)300×(D)550×(H)195mm 約12kg (RF-110MK2)
- (W)340×(D)590×(H)210mm 約16kg (RF-110N2MK2)

## 適合基板

- 寸法 : 10×10mm ~200×200mm
- 板厚 : 0.1~2mm
- 高さ : MAX20mm

## 用途

- H-ICやSMT基板のリフローはんだ付け。
- 非洗浄タイプクリームはんだのリフローはんだ付け。
- BGAパッケージへのボールはんだ搭載。
- 熱硬化接着剤の乾燥。
- その他加熱作業。

## オプション

- 動作表示灯

※本仕様は予告なく変更することがあります。